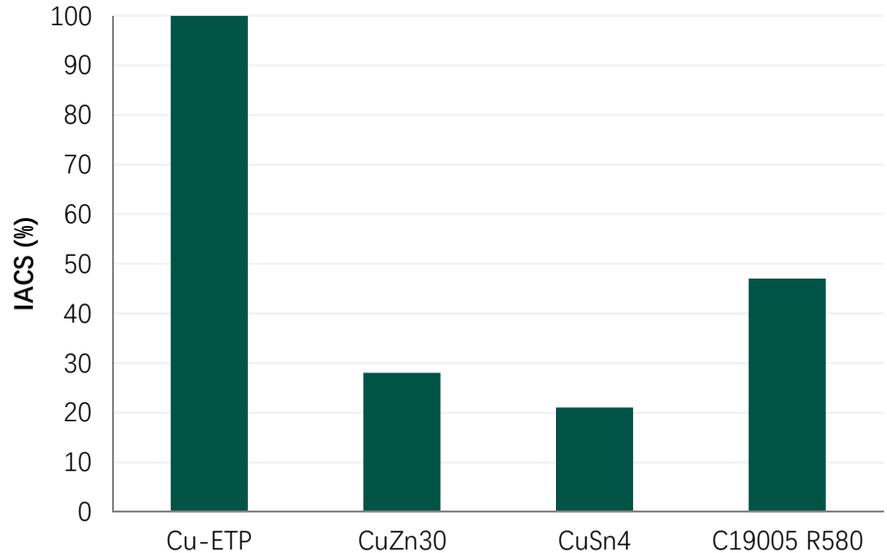


3.4 Cu-ETP-C11000 - CW004A

应用范围								
电子元器件基本材料								
物理性能							化学成分 (参考值) %	
密度 *		克/厘米 ³		8.9		铜		99.9
导热性 *		瓦/(米·开)		394		氧		≤ 0.040
导电率 ***		毫西门子/米		58/57		<p style="text-align: center;">所选合金导电率 (IACS%)</p> 		
导电率 ***		IACS (%)		100/98.3				
热膨胀系数 **		10 ⁻⁶ K		17.7				
弹性模量 *		千兆帕		127				
状态	强度等级	抗拉强度	屈服强度	延伸率	硬度	导电性	弯曲性能	
		T.S. 最小值-最大值 兆帕	Rp 0.2 最小值 兆帕	A50 最小值 %	(参考值) 维氏硬度		R/t ¹⁾²⁾ 90° 好的方向 铜带厚度 ≤0.5mm	坏的方向 铜带厚度 ≤0.5mm
冷加工硬化	R220	220 - 260	(max. 140)	33	40 - 65	58	0	0
冷加工硬化	R240	240 - 330	180	10	65 - 95	57	0	0
冷加工硬化	R290	290 - 360	250	4	90 - 110	57	0	0.5
冷加工硬化	R360	min. 360	320	2	min. 110	57	1	2

*室温下的参考值

**温度范围 20 - 300°C

*** 最低强化状态下的数值

¹⁾ $r = x \cdot t$ (适用于铜带厚度 $t \leq 0.5\text{mm}$)

²⁾ 样品宽度=10mm/可以根据要求在更窄的宽度进行弯曲测试 (评估方法依据手册5.4.2页)

免责声明：由于生产工艺可能对更改及差异，本手册及数据表上公布的信息不能保证。本公司保留更改、修订上述内容的权利。因所提供的信息造成的任何问题，本公司不承担责任。